

# 簡歷表

## 基本資訊

姓名:郭景智

生日:82.07.30

電絡電話:0932201448

個人信箱:s41001638@gmail.com

## 簡介

我是郭景智，靜宜大學食品營養學系畢業。勇於挑戰新事物，勤於學習新領域。現任惠特科技產品工程師。



# 工作經歷



惠特科技 ( 2024/6~至今 )

CoWoS-oS自動化封裝設備負責人

Broadcom雷射二極體檢測設備負責人



天方科技 ( 2023/9~2024/4 )

Vue搭配C#後端開發校務系統



資策會 ( 2023/2~2023/8 )

學習網頁開發:HTML/CSS/JavaScript/Vue

共同合作專題:線上租賃平台



日月光半導體 ( 2020/10~2022/10 )

負責WB打線封裝設備

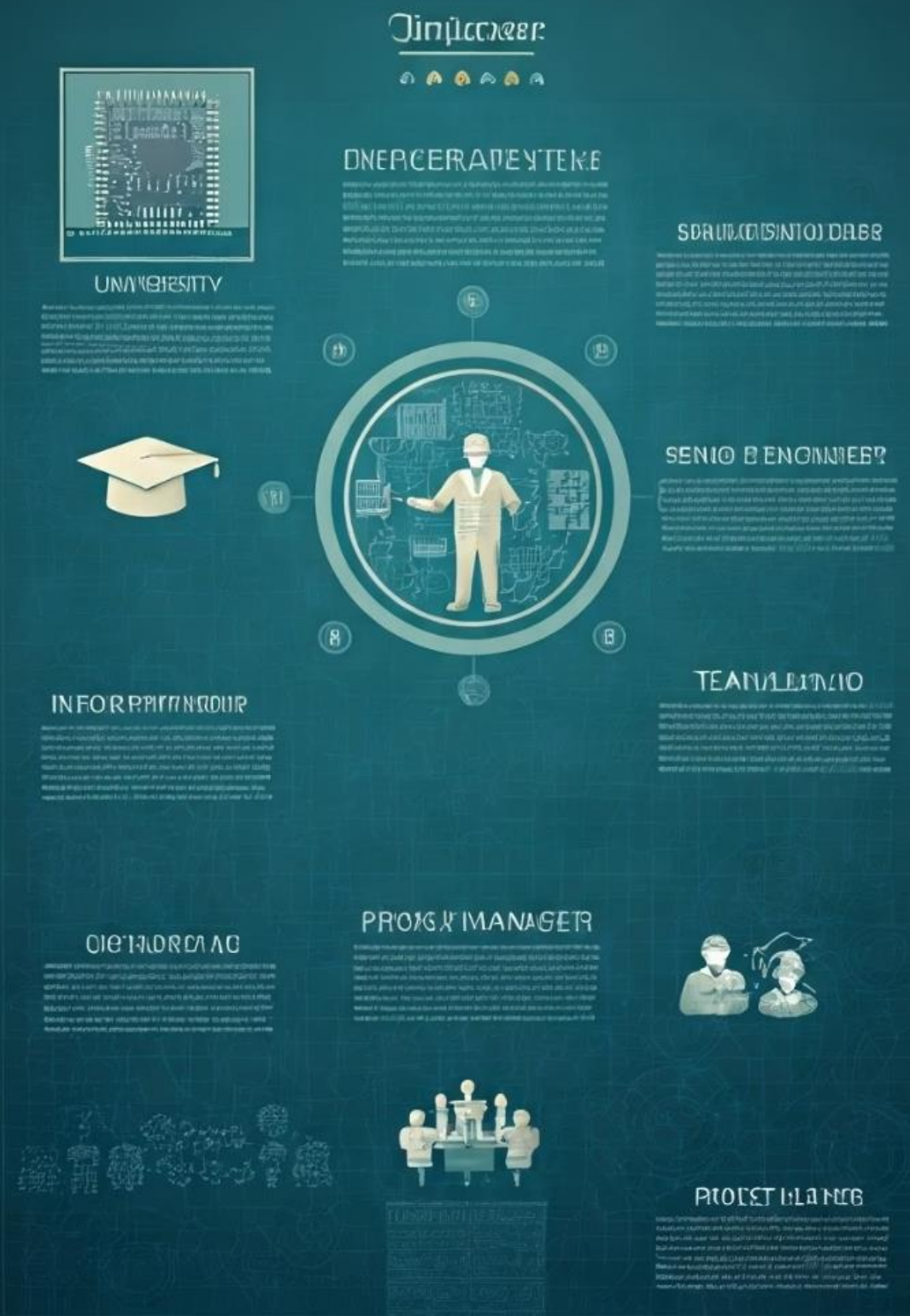
MTBA改善負責人、協助DUC計畫導入專案



和大工業 ( 2017/4~2022/9 )

國內外售服工程師(印度/全台灣)

負責齒輪創成設備，參與諧波減速機專案



# 學習計畫

## 短期（進研究所前）

- 強化英文能力:每周閱讀三篇英文時事新聞
- 基礎知識補強：材料導論與物理冶金

## 中期（念研究所）

- 閱讀論文:每三周一篇到一週能看一篇
- 修習先進封裝與材料工程相關課程

## 長期（畢業後）

- 期望發展:CoWoS/CoPoS/SOIC等先進封裝相關領域

# 研究計畫

## 研究方向

從材料工程的角度切入，深入了解CoWoS製程中導線材料如何影響結果，以及材料結構對於散熱表現提升。

## 研究動機

先後任職於日月光與惠特，前者接觸傳統打線封裝。對於晶片包裝成一顆顆成品有濃厚的興趣，任職於惠特科技接觸CoWoS相關設備，雖然是末端製成。仍深刻體認到該技術有非常高的發展潛力，工作的過程中看著散熱片透過散熱膠接合兩者。每一個製程站都有各自的關鍵點，不同材料要以多少膠量搭配散熱片壓合後才會形成最好的結果，期能以材料角度深入理解，並由後段往前段製程學習。

# 惠特科技工作經驗

## CoWoS-OS設備

熟悉四大製程（貼膜/點膠/植片/熱壓），深入了解晶片黏貼散熱片設備的運作原理與維護要點。

## 製程問題解決

改善點膠站散熱膠膠寬過寬問題，透過理解軟體計算材料厚度的方法，分析紀錄檔案，找出可作為參考的雷射量測數據。





# 日月光半導體工作經驗



## 打線製程專業

熟悉打線製程，了解金銅線如何透過鋁墊連接不同尺寸晶片與載版。各產品間依據需求有疊層、線弧角度及共晶模式的交互調整。



## 良率改善分析

從鋁墊共晶角度切入分析，判斷共晶強度對良率的影響，透過溫度、時間、震盪等基本概念調整參數，解決良率不佳等機台問題。



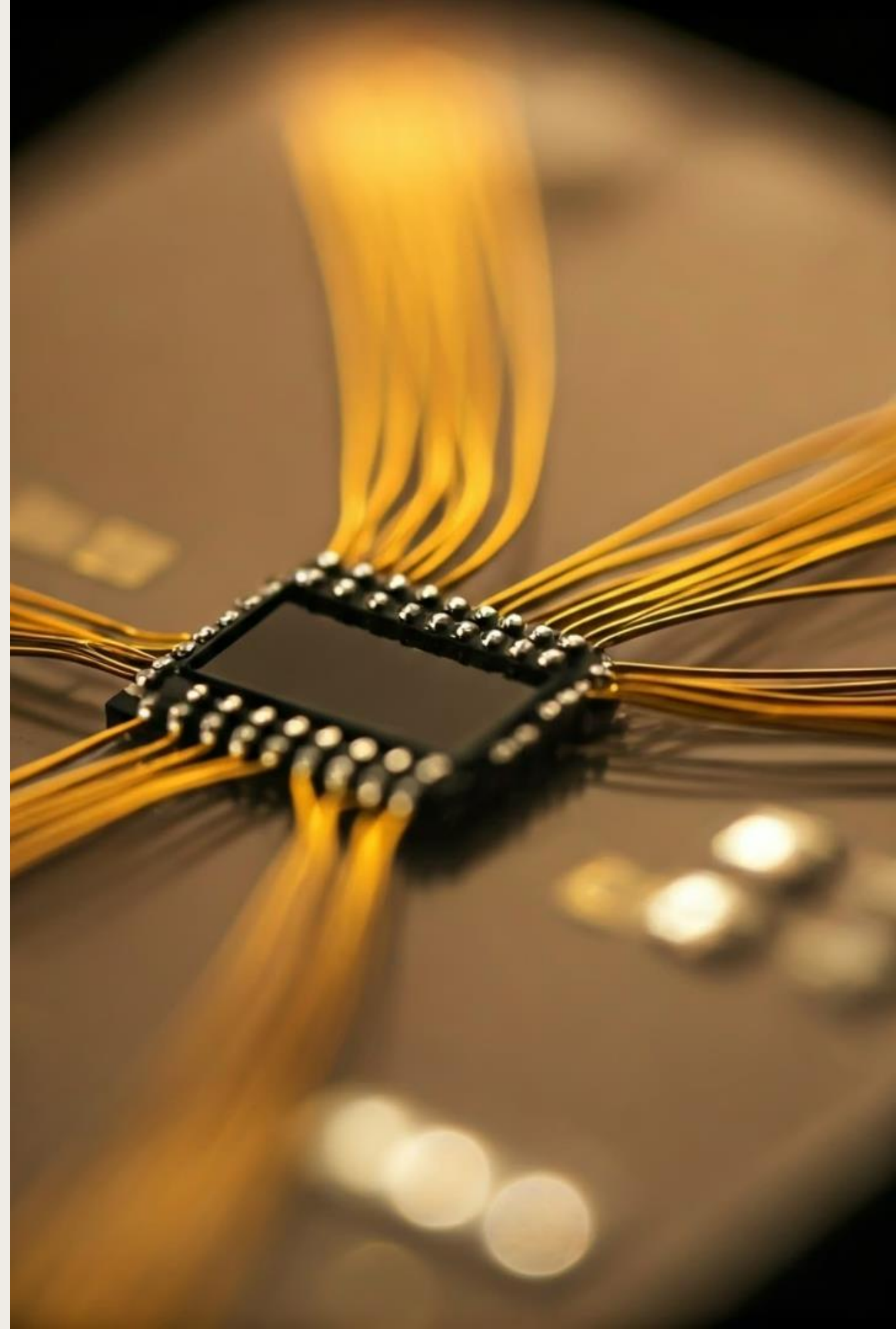
## MTBA改善計畫

參與平均故障間隔改善計畫，六種Alarm總和下降至10ppm，顯著提高設備穩定性與生產效率。



## DUC導入實驗

參與超聲波清潔技術導入，驗證其在解決流體邊界層效應下的粒子污染問題的有效性，提升產品品質。



# 和大工業工作經驗

## 品保專業

工作內容涵蓋入料檢驗到出機測試，針對組裝異常進行檢測及回報給設計部門做判斷。

## 特殊專案

參與齒輪創成齒形改善計畫，並獲選參與盟立集團開發諧波減速機計畫。



## 售服工程

轉至售服部門後，增加設備熟悉度，協助國內外客戶調整良率，提供專業技術支援。

## 熱膨脹改善

參與因熱膨脹導致加工尺寸偏移的改善計畫，改善溫度變化對精密加工的影響。